

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023 年 2 月 28 日

调研形式：现场调研

调研机构：天风证券

上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：请介绍一下公司募投项目进展情况？

答复：公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目和高导热填充粉体材料生产建设项目正在按计划建设中，目前电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目主体工程施工已基本完成，预计三季度开始将有新的产能逐步释放。

问题 2：募投项目年产 5 万吨电子陶瓷粉体材料生产线未来产品规划情况？

答复：按照既定规划，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目的产能将主要用于电子陶瓷芯片基板领域，小部分用于 IGBT 半导体器件和真空管壳领域。随着下游消费电子行业、新能源领域和电力行业需求的释放，原有客户均不同程度的扩建新产线，新客户拓展亦在积极对接中。

问题 3：公司对 IGBT 行业的市场容量情况预计？

答复：作为新型功率半导体器件的主流器件，IGBT 可广泛应用于轨道交通、

新能源、智能电网、新能源汽车等战略新兴产业领域。随着近年来全球 IGBT 行业发展向好，其市场规模也随之逐年递增，根据 ASMC 研究显示，全球 IGBT 市场规模在 2022 年达到 60 亿美元。电子陶瓷用粉体材料可用于生产 IGBT 基板，预计未来市场空间广阔。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日